



证券代码：002079

证券简称：苏州固锴

公告编号：2026-013

苏州固锴电子股份有限公司

SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD.

002079

2025 年年度报告摘要



二〇二六年四月二十九日

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 908,126,323 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	苏州固锝	股票代码	002079
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李莎		
办公地址	江苏省苏州市高新区通安镇华金路 200 号		
传真	0512-68189999		
电话	0512-66069609		
电子信箱	lisha@goodark.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司核心业务聚焦半导体与新材料两大板块，半导体主要涉及分立器件与集成电路封测、新材料主要涉及光伏浆料研发生产，构建了“研发 - 生产 - 销售”全链条运营体系与全球化产业布局。

（一）分立器件与集成电路封测业务经营情况

公司是国内最大的整流器生产工厂之一，深耕半导体领域三十余年，拥有完整的半导体封装测试全流程技术能力，具备多规格晶圆全流程封测能力。2025 年，业务情况如下：

1. 产品矩阵持续完善：公司产品覆盖整流二极管芯片、微型桥堆、光伏旁路模块、无引脚集成电路封装产品、MOS 器件、IGBT 器件、小信号功率器件、传感器封装等 50 多个系列、7000 多个品种，广泛应用于汽车电子、工业与通信、电源管理、消费电子等领域，同时为多家国际知名分立器件企业提供 OEM 服务。



2. 高端化战略落地见效：聚焦车规级、工业级高端市场，优化产品结构，推进车规级半导体产品的客户认证与批量供货，完成多家头部车企与汽车零部件厂商的供应商准入，车规级产品营收占比稳步提升。

3. 产能建设稳步推进：推进“小信号产品封装与测试”募投项目建设，项目建成后将形成年产 50 亿件 SOT23、SOD123 系列小信号器件的生产规模，实现小信号器件从委外加工到自主生产的转型，显著提升产品毛利率与核心竞争力。

4. 供应链与生产优化：加大国产化设备与材料的应用，与核心供应商达成战略合作，推进金线转铜线键合、高密度框架设计等关键技术突破，持续推进生产自动化与精益化管理，降本增效成效显著。

(二) 光伏浆料业务经营情况

公司依托全资子公司苏州晶银开展光伏浆料业务，是国内首批实现银浆本土化的国际知名光伏电池导电浆料供应商。依托自身的研发与技术优势，是国内首家完成 HJT 低温浆料产业化并在全球率先实现银包铜低温浆料量产应用的企业，持续推动行业少银、无银技术升级。2025 年，业务情况如下：

1. 全技术路线产品布局完成：已实现 TOPCon 电池用高温银浆、HJT 电池用低温银浆及银包铜浆料、BC 电池用银浆、高效 PERC 电池用银浆全系列产品产业化，全面适配行业主流与前沿电池技术路线，具备快速响应客户定制化需求的能力。

2. 产能扩张有序推进：推进“年产太阳能电子浆料 500 吨项目”建设，项目建成后将大幅提升公司 TOPCon 与 HJT 银浆产能，进一步提升市场份额与规模效应。

3. 技术迭代持续领先：重点推进低银化、低成本浆料研发，第四代 HJT 电池用低温银包铜浆料实现批量供货，银含量降至 10%-20%，显著降低客户电池生产成本；BC 电池专用银浆完成头部客户量产应用；钙钛矿叠层电池用超低温纯银浆料完成实验室研发，TOPCON 和 BC 电池用银包铜浆料成功开发，技术储备行业领先。

4. 客户与市场拓展深化：与全球头部光伏企业保持长期稳定合作，同时拓展东南亚海外市场，依托马来西亚生产基地构建“本土化 + 东南亚”双循环产能体系，拓宽盈利渠道，抵御地缘政治风险。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2025 年末	2024 年末		本年末比上年末增减	2023 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后



总资产	3,791,082,159.63	4,170,231,669.53	4,183,414,219.98	-9.38%	3,926,079,717.36	3,937,926,325.89
归属于上市公司股东的净资产	3,106,769,034.36	3,026,106,811.16	3,028,665,269.19	2.58%	2,908,082,300.37	2,912,410,488.38
	2025 年	2024 年		本年比上年增减	2023 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,959,936,275.17	5,637,955,445.62	5,647,375,817.12	-29.88%	4,087,354,532.52	4,094,036,632.26
归属于上市公司股东的净利润	73,438,500.75	73,690,959.92	71,921,229.94	2.11%	153,288,440.18	153,087,668.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,284,139.36	50,876,153.01	50,876,153.01	-60.13%	138,070,828.10	138,070,828.10
经营活动产生的现金流量净额	523,125,111.36	82,011,041.04	79,711,423.31	556.27%	217,525,301.03	208,499,811.20
基本每股收益(元/股)	0.0908	0.0913	0.0891	1.91%	0.1901	0.1899
稀释每股收益(元/股)	0.0908	0.0914	0.0892	1.79%	0.1907	0.1905
加权平均净资产收益率	2.39%	2.49%	2.43%	-0.04%	5.45%	5.44%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	901,084,268.57	1,091,841,551.75	1,027,448,183.59	939,562,271.26
归属于上市公司股东的净利润	36,817,574.79	6,884,476.57	18,813,971.27	10,922,478.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,153,791.86	5,920,173.59	7,105,358.73	-895,184.81
经营活动产生的现金流量净额	-14,486,532.99	191,326,250.30	71,561,216.08	274,724,177.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股	106,488	年度报告披露日前	107,120	报告期末表决权恢	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先	0
----------	---------	----------	---------	----------	---	----------------------	---



东总数		一个月末 普通股股 东总数		复的优先 股股东总 数		股股东总数	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
苏州通博 电子器材 有限公司	境内非国 有法人	23.11%	187,344,255.00	0.00	不适用	0	
苏州阿特 斯阳光电 力科技有 限公司	境内非国 有法人	1.18%	9,537,601.00	0.00	不适用	0	
香港中央 结算有限 公司	境外法人	1.08%	8,779,994.00	0.00	不适用	0	
招商银行 股份有限 公司—南 方中证 1000 交 易型开 放式指 数证券 投资基 金	其他	0.74%	5,982,400.00	0.00	不适用	0	
招商银行 股份有限 公司—华 夏中证 1000 交 易型开 放式指 数证券 投资基 金	其他	0.46%	3,756,271.00	0.00	不适用	0	
郭乔坡	境内自然 人	0.36%	2,923,350.00	0.00	不适用	0	
王贺军	境内自然 人	0.35%	2,846,103.00	0.00	不适用	0	
中国工商 银行股份 有限公司 —广发中 证 1000 交 易型开 放式指 数证券 投资基 金	其他	0.33%	2,708,400.00	0.00	不适用	0	
余忠国	境内自然 人	0.29%	2,380,300.00	0.00	不适用	0	
刘晓峰	境内自然 人	0.25%	2,053,779.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一 致行动的说明	上述股东之中，苏州通博电子器材有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东 情况说明（如有）	股东郭乔坡通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,923,350 股；股东王贺军通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,846,103 股。股东刘晓峰通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,053,779 股。						



持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

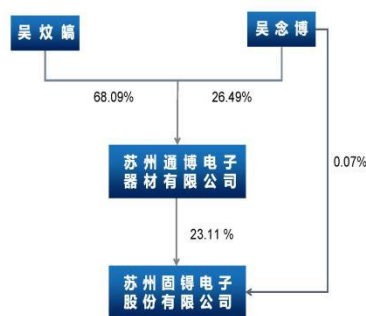
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

公司总部位于中国苏州，同时在新加坡设有海外研发与管理总部。生产基地分布于苏州、宿迁、成都及马来西亚，在美国、日本及中国台湾等国家和地区布局销售网点，销售网络覆盖全球。截至 2025 年末，公司实现营业收入 39.59 亿元。其中，半导体业务收入 9.31 亿元，核心产品市场份额保持稳定；新材料业务收入 29.51 亿元，苏州晶银基于对下游行业风险的审慎判断，主动优化业务布局、收缩市场份额，实现稳健经营。公司资产总额 37.91 亿元，负债总额 6.67 亿元，资产负债率 17.59%，始终保持低位，财务结构稳健；现金及现金等价物余额 4.32 亿元，现金流稳定，具备充足的抗风险能力与业务扩张空间。

2025 年，公司坚持自主研发、内生增长，持续加大研发投入，近三年累计研发投入超 4 亿元。截至 2025 年末，公司拥有境内专利共计 242 项，其中发明专利 93 项、实用新型专利 147 项、外观设计专利 2 项；技术人员占公司总人数比例近 1/3，核心研发团队稳定，技术实力行业领先。2025 年，半导体领域公司获得“江苏省先进级智能工厂”的称号；



新材料领域也不断突破，苏州晶银的新产品获苏州市工信局首批次新材料推广应用奖励，江苏省中央外经贸发展专项资金，江苏省新材料产业协会科学技术奖二等奖荣誉。

苏州固锴电子股份有限公司

2026 年 4 月 29 日